

A grayscale background image showing a close-up of industrial machinery, likely a mold or a precision manufacturing tool, with various cylindrical and rectangular components.

2025年3月期 第2四半期(中間期)

(2024年4月1日 ~ 2024年9月30日)

決算説明資料

2024年11月28日

ENOMOTO Co.,Ltd.

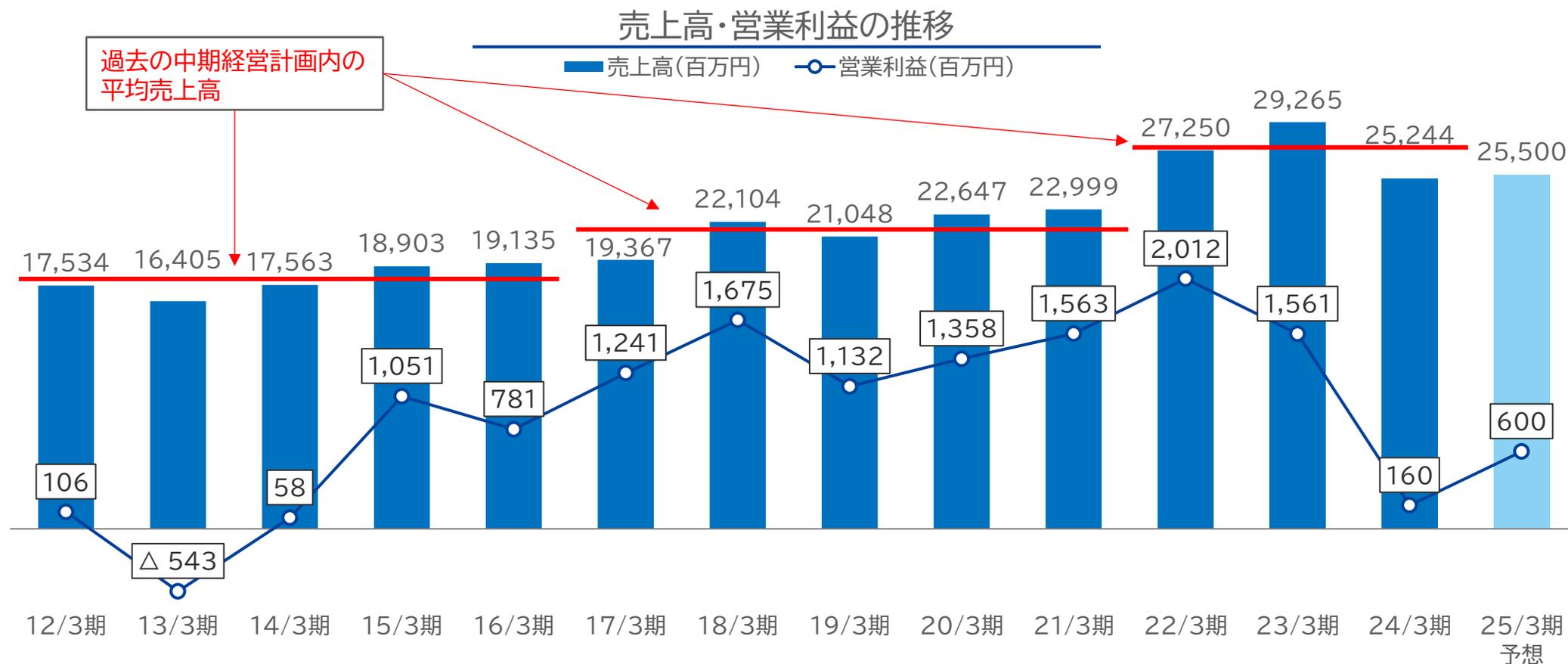
東証プライム 証券コード:6928

(1) 業績概要	P. 3
(2) 当社製品と強み	P. 6
(3) 2025年3月期第2四半期(中間期)決算	P.14
(4) 2025年3月期業績予想	P.20
(5) 中期経営計画の進捗	P.26
Appendix	P.35

(1)業績概要



- 2021年3月期までの5年間は、マイクロコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- ビジョン2030 1st STEPでは、22年3月期に過去最高益を計上したものの、23年3月期4Qからはスマートフォンを中心として民生・産機向けが調整局面に
- 津軽工場新棟など先行投資に伴う償却費の増加もあり24年3月期は大幅減益
- 2nd STEPで1st STEPでの先行投資の刈り取りを狙う



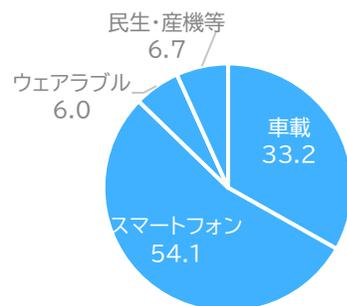
- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けは比較的堅調だが、民生・産機向けの汎用リードフレームが調整
- ・ オプト用リードフレームは大型ディスプレイ向けが減少
- ・ コネクタ用部品は車載向けは回復したが、スマートフォン向けが低迷

その他

売上高 495百万円
 前同比 $\Delta 25.0\%$
 構成比 2.0%

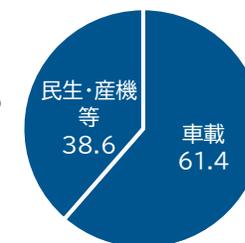
コネクタ用部品

売上高 10,989百万円
 前同比 $\Delta 14.9\%$
 構成比 43.5%



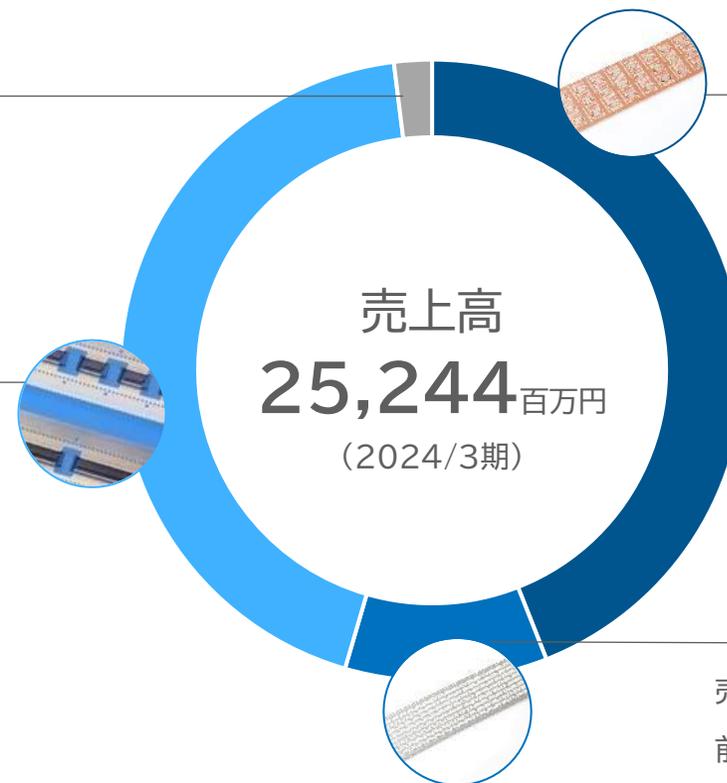
パワー半導体用リードフレーム

売上高 11,112百万円
 前同比 $\Delta 7.2\%$
 構成比 44.0%



オプト用リードフレーム

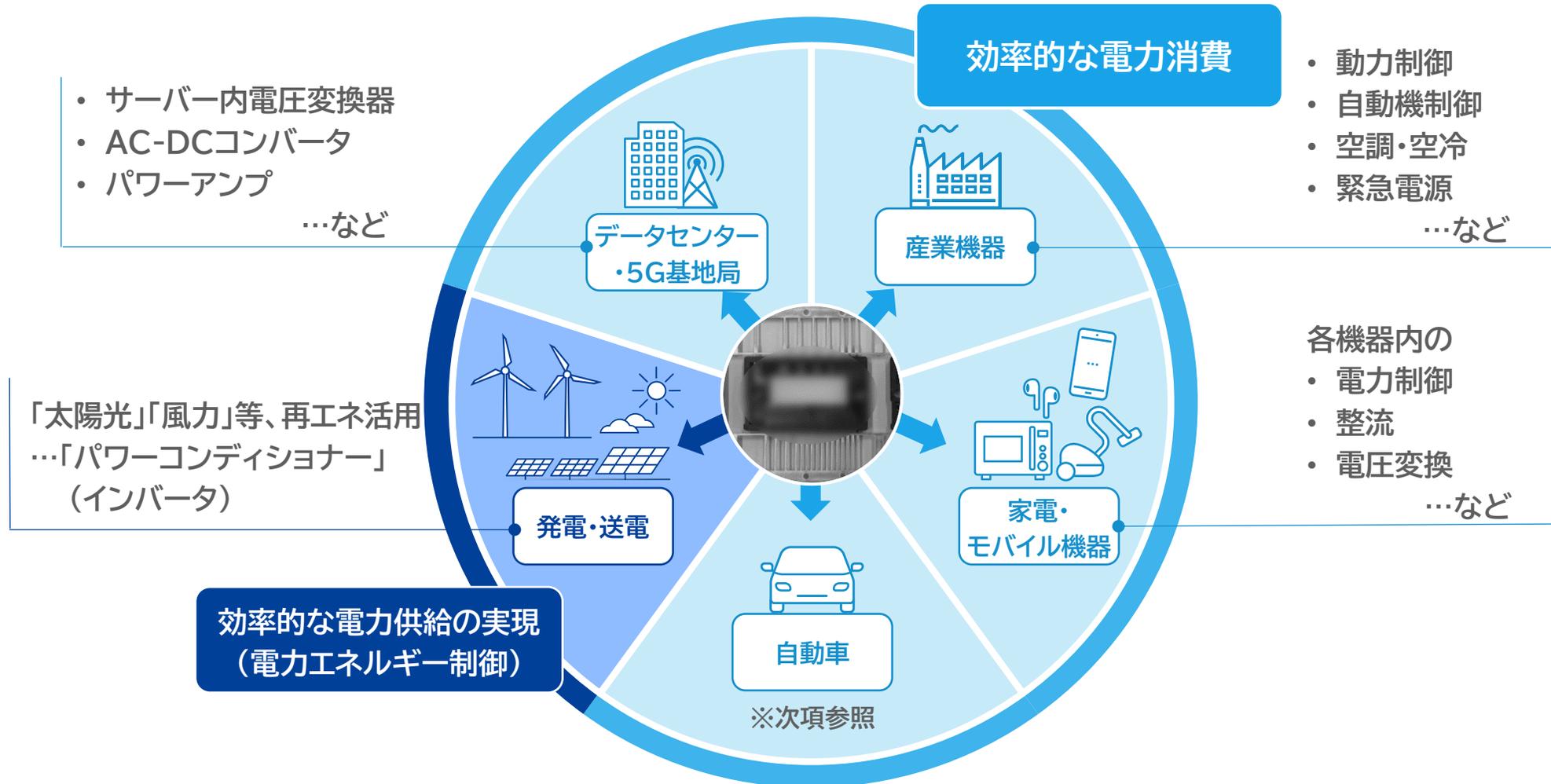
売上高 2,647百万円
 前同比 $\Delta 28.8\%$
 構成比 10.5%



(2) 当社製品と強み

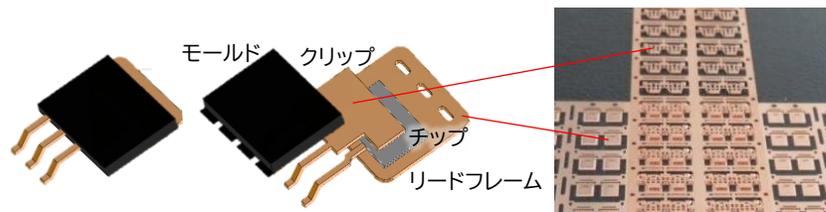


- xEVやデータセンター向けなどに高効率な電力供給を支える高性能パワー半導体に、環境側面からも注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・大電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与



* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



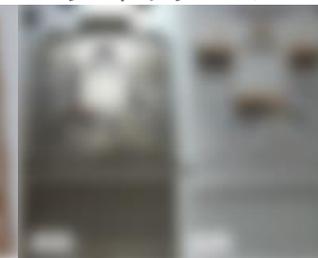
汎用パワー半導体用
リードフレーム



IGBT用
リードフレーム



パワーIC用
リードフレーム



パワーデバイス適用製品

計**40**品種以上

パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- レギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



車両制御

- ステアリング制御
- クルーズ制御

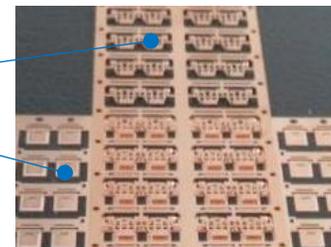
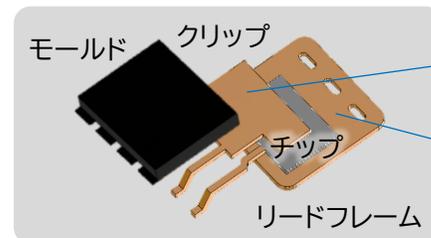
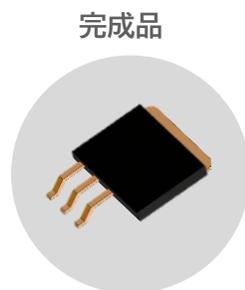
ボディ制御

- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

- 車載ECU*1やデータセンター向けパワー半導体の高電圧・大電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディングの注目が高まる
- 需要は拡大しており2023年3月期に計画前倒しでリードフレームの生産能力を増強。平坦度などの品質要求が高く付加価値率も高い



クリップボンディングリードフレーム



高耐熱性

長寿命化

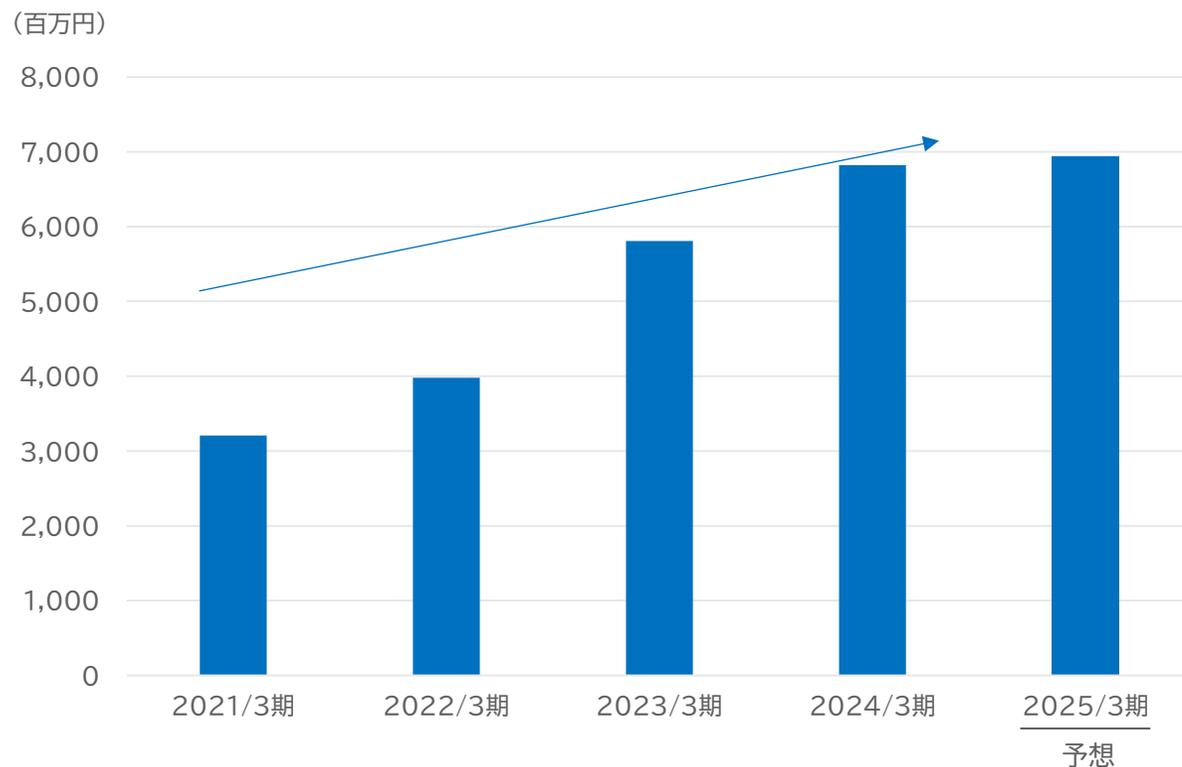
- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度(位置精度)が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

平坦度(位置精度)・清浄度の要求が高く、高い付加価値率

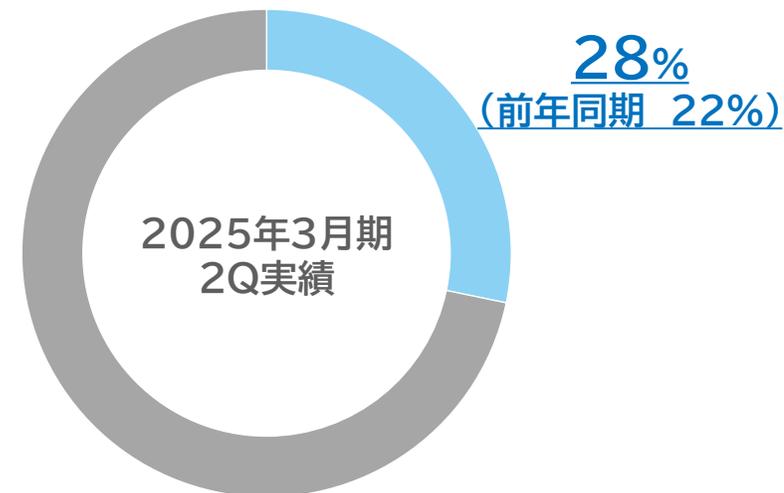
*1 ECU Electronic Control Unit

- 当社のパワー半導体用リードフレームに占める車載向けは好調に推移、24年3月期まで過去3年は年平均29%成長
- クリップボンディングリードフレームなどを世界上位のパワー半導体メーカーに向けて拡販を図り、リードフレーム事業の利益率向上を目指す

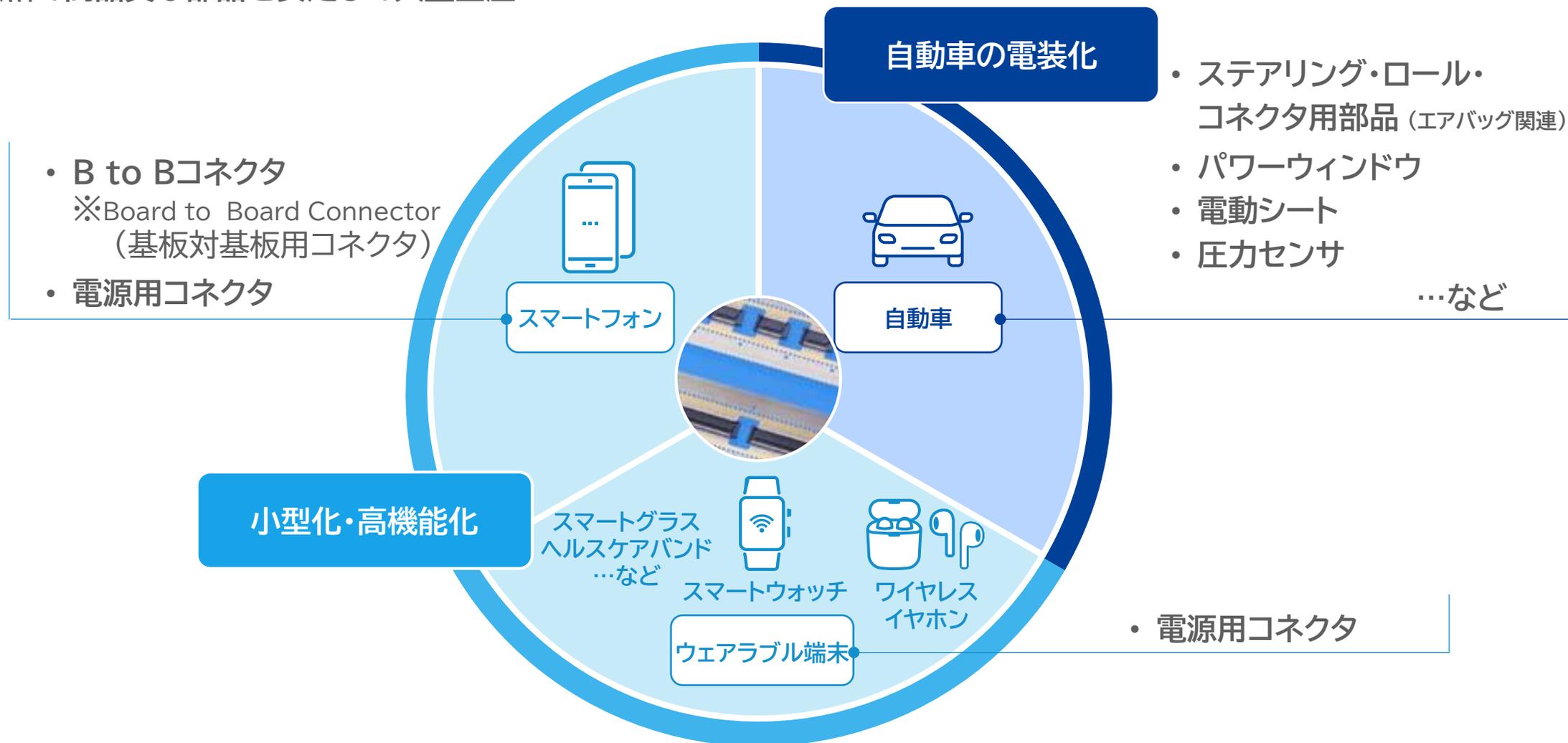
車載向けパワー半導体用リードフレームの売上高推移



パワー半導体用リードフレームに占めるクリップボンディングリードフレームの構成比

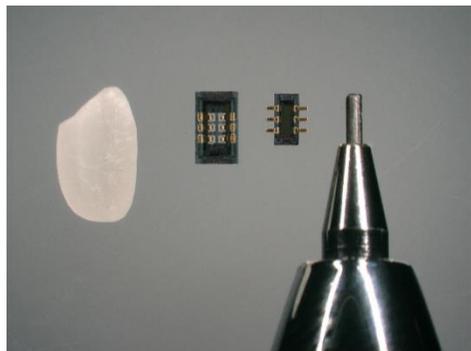


- スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- 超微細で高品質な部品を安定して大量生産



1

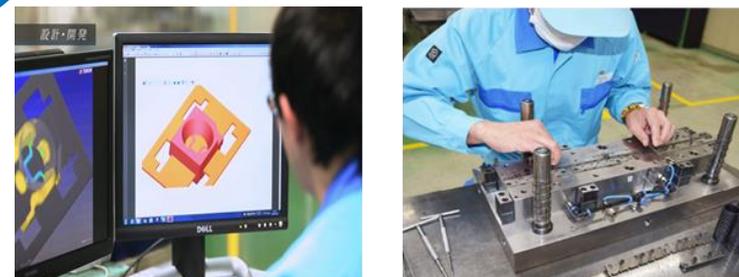
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制

中国

クリップボンディング
リードフレームで先行



フィリピン

車載向けコネクタ用部品の
主力工場



一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

材料メーカーや
協力会社

幅広い顧客
ニーズ

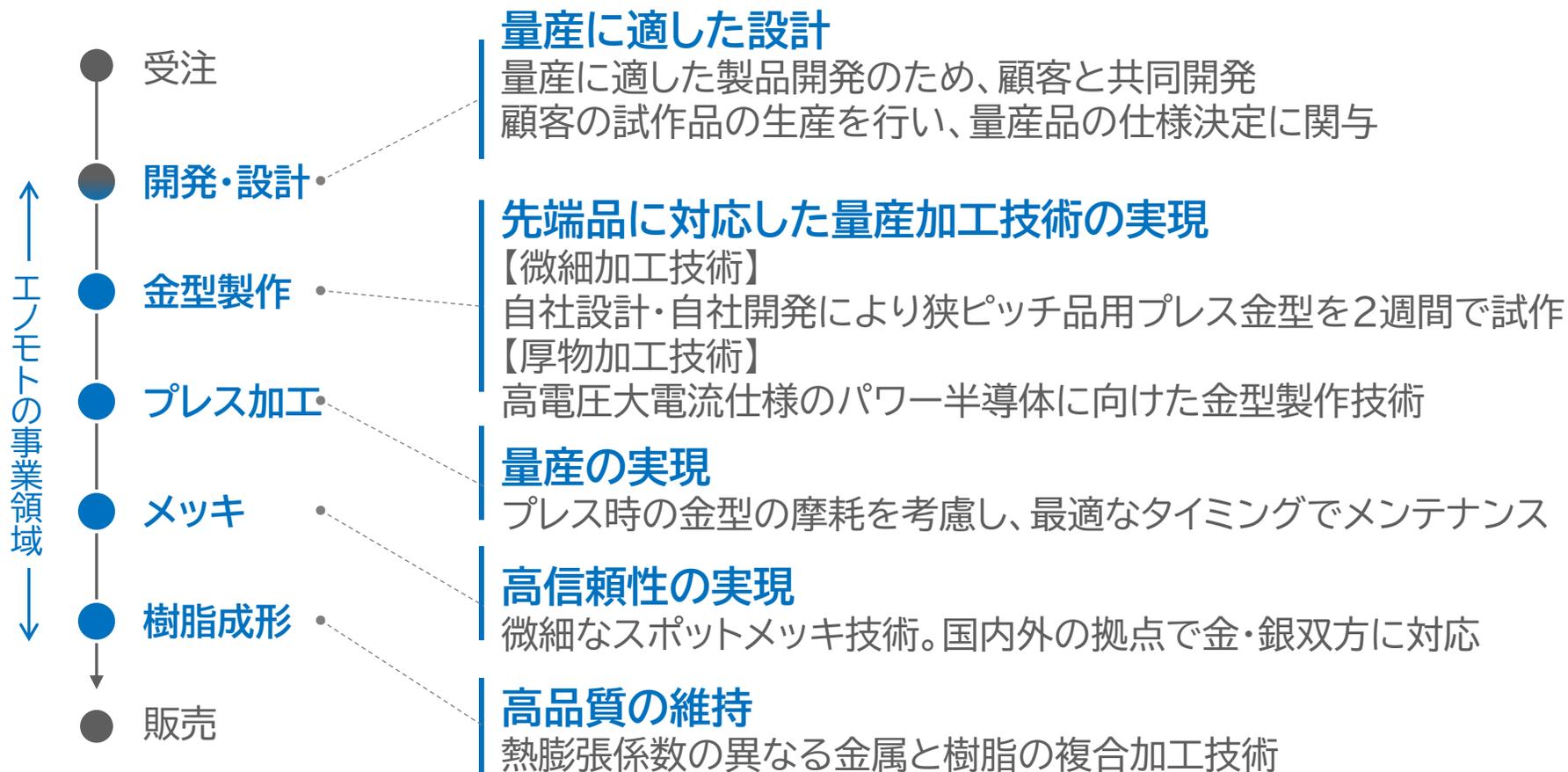
最適な調達

エノモト

柔軟な対応

特定の資本に縛られない
自由な営業方針

- 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- スマートフォン向けなどのマイクロコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



(3) 2025年3月期第2四半期(中間期)決算

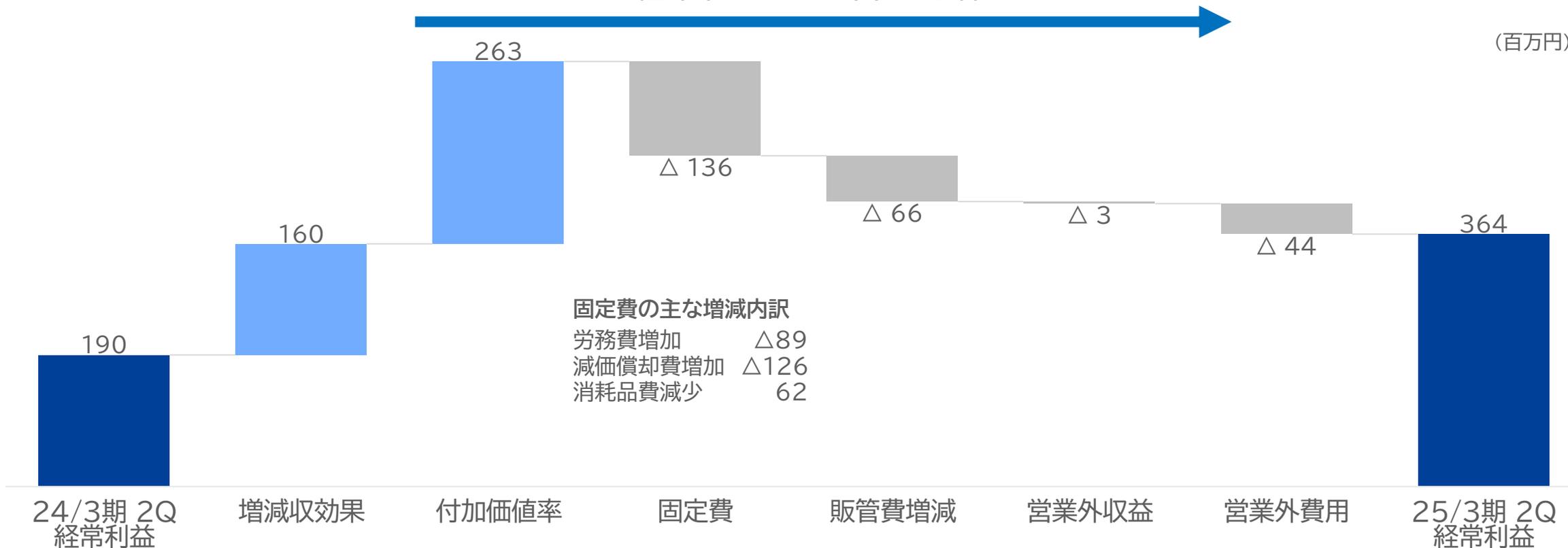


- 上期実績は期初想定線ながら増収増益。オプト向けでハイエンド品の出荷が始まったことや、コネクタ部品のウェアラブル端末向けが回復したものの本格的な回復水準には戻らず
- 増収に伴う稼働率の改善により粗利率も上昇

単位:百万円	2023/3期2Q累計		2024/3期2Q累計(前中間)		2025/3期2Q累計(当中間)		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前同比(%)
売上高	14,650	100.0	13,020	100.0	13,419	100.0	3.1
売上総利益	2,173	14.8	1,364	10.5	1,651	12.3	21.0
販管費	1,234	8.4	1,227	9.4	1,293	9.6	5.4
営業利益	938	6.4	137	1.1	358	2.7	161.1
為替差損益	138	0.9	29	0.2	△56	-	-
経常利益	1,127	7.7	190	1.5	364	2.7	91.6
当期純利益	778	5.3	87	0.7	270	2.0	208.7
1株当たり純利益	116.58円	-	13.10円	-	40.45円	-	
1株当たり中間配当金	30.0円		35.0円		35.0円		

- 増減収効果 ウェアラブル端末向け等のコネクタ用部品が増収、オプト用リードフレームも底打ち
- 付加価値率 マイクロコネクタやクリップボンディングリードフレームの増加により製品ミックスは改善
- 固定費 ①生産能力増強に伴い金型等の減価償却費増加、稼働率上昇により労務費も増加
 ②原価低減活動により、消耗品費は減少

経常利益: 174百万円増加



- 車載はパワー半導体用リードフレームが横ばい、エアバッグ用などは顧客企業の出荷停止の影響を受けつつも堅調
- スマートフォンは新モデル向けが前年同期比で減少、ウェアラブルは底打ち
- 民生・産機・その他の汎用パワー半導体用リードフレームが調整継続、LEDはハイエンド品の金型売上及び量産が始まり回復傾向

民生・産機・その他

- 構成比は前年同期の30.7%から 4.2pt減少
前年同期比 12.7%減少
- PC向けを含む汎用パワー半導体用
リードフレームの在庫調整
- 大型ディスプレイ向けの
LED用リードフレームの在庫調整

ウェアラブル

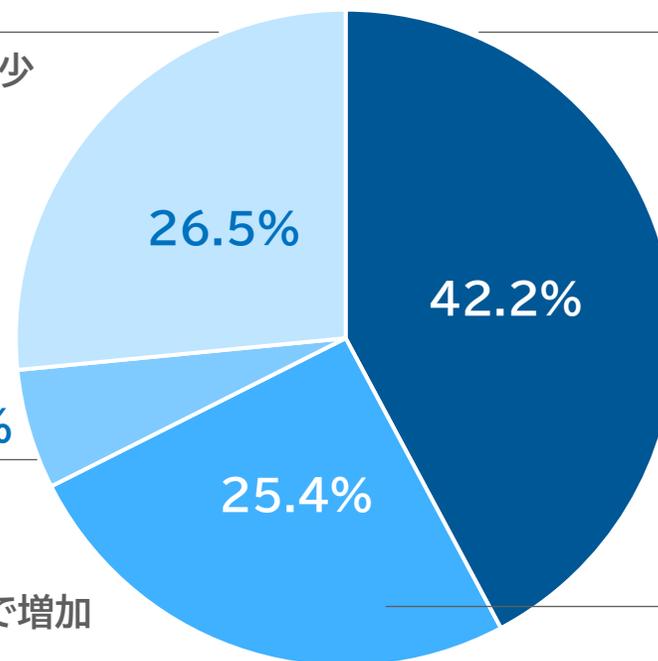
- 構成比は前年同期の1.8%から 4.1pt増加
前年同期比 228.6%増加
- ワイヤレスイヤホンやウォッチの新製品向けで増加

車載

- 構成比は前年同期の40.7%から 1.5pt増加
前年同期比 4.5%増加
- xEV向けパワー半導体用リードフレームは横ばい
- エアバッグ向けコネクタ等は堅調

スマートフォン

- 構成比は前年同期の26.8%から 1.4pt減少
前年同期比 4.6%減少
- スマートフォン向けコネクタ部品の減少



- 第2四半期は前年同期比、1Q比ともに増収増益
- 利益面では、稼働率の上昇やマイクロコネクタなど付加価値の高い製品の増収により増益

単位:百万円	2024/3期					2025/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比(%)	1Q比(%)
売上高	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	6,912	+4.8	+6.2
売上総利益	722	642	730	558	2,654	749	902	+40.4	+20.4
販管費	590	637	626	639	2,494	645	648	+1.7	+0.5
営業利益	132	4	103	△80	160	104	253	+5302.5	+143.0
為替差損益	12	16	△41	29	17	5	△61	-	-
経常利益	162	27	89	12	291	135	228	+727.1	+68.3
四半期純利益	96	△9	29	3	121	47	223	-	+373.6

- 売上高は2024年3月期4Qをボトムに回復トレンド
- パワー半導体用リードフレームは車載向けが横ばい、民生・産機向けは調整が続いた
- オプト用リードフレームは大型ディスプレイ向けは低迷が続いたが、ハイエンド品の量産が始まり、全体として底打ち
- コネクタ用部品はスマートフォン向けが減少し車載向けは前期並みだが、ウェアラブル端末向けは新製品向けで増加

単位:百万円	2024/3期					2025/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比 (%)	1Q比 (%)
パワー半導体用 リードフレーム	3,164	2,832	2,516	2,598	11,112	2,662	2,734	△3.5	+2.7
オプト用 リードフレーム	712	662	648	624	2,647	728	742	+12.1	+1.9
コネクタ用部品	2,437	2,970	2,863	2,717	10,989	2,959	3,248	+9.4	+9.8
その他	112	129	141	112	495	156	188	+45.3	+20.4
合計	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	6,912	+4.8	+6.2

(4) 2025年3月期業績予想



- 上期は増収増益となったが、下期はスマートフォン向けコネクタ部品の季節調整等を見込むことから通期予想は継続
来期は車載向けのコネクタ部品の回復やLEDリードフレームのハイエンド品の生産拡大などのプラス要因があり
2024年3月期をボトムに回復に向かうという中期経営計画の方向は変わらず
- 増収に加えて、付加価値の高い製品の増加により増益を予想

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	29,265	100.0	25,244	100.0	25,500	100.0	+1.0
売上総利益	4,100	14.0	2,654	10.5	3,150	12.4	+18.7
販管費	2,538	8.7	2,494	9.9	2,550	10.0	+2.2
営業利益	1,561	5.3	160	0.6	600	2.4	+274.4
経常利益	1,805	6.2	291	1.2	600	2.4	+105.5
当期純利益	1,269	4.3	121	0.5	450	1.8	+271.0
1株当たり当期純利益	190.02円	-	18.16円	-	67.64円	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	71.0円	-	-

- ・ パワー半導体向けリードフレームは中国向けの民生・産業機器向けが調整継続、下期後半からの底打ちを見込む
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の量産が始まり、四半期ごとに増加する見通し
- ・ コネクタ用部品はスマートフォンの新モデル向けで下期から季節調整を見込む
一方で車載向けは顧客の生産再開により堅調

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,112	44.0	10,500	41.2	△5.5
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,647	10.5	3,500	13.7	+32.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,989	43.5	11,000	43.1	+0.1
その他	659	2.3	495	2.0	500	2.0	+1.0
合計	29,265	100.0	25,244	100	25,500	100.0	+1.0

- ・ パワー半導体向けリードフレームは足下は中国向けの民生・産業機器向けが調整継続、来期以降の底打ちを見込む
- ・ オプト用リードフレームは新規の受注案件が順次量産・出荷開始
- ・ コネクタ用部品は在庫調整が完了し、特にウェアラブル端末向けで市場成長に伴う増加を見込む

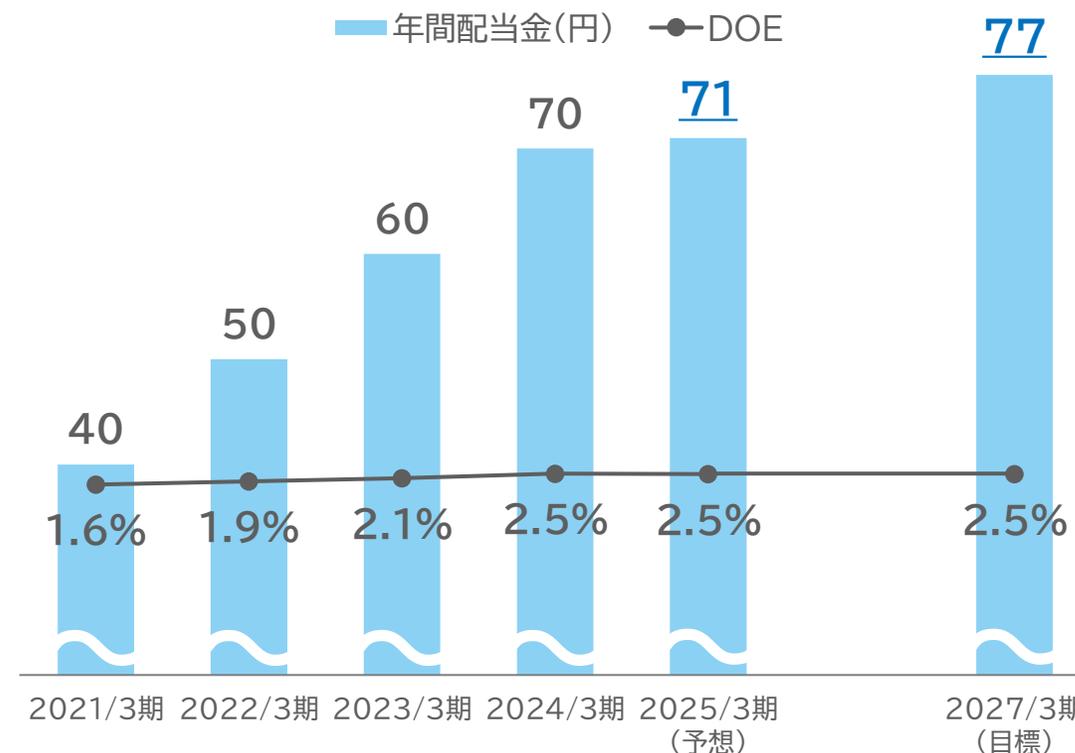
単位:百万円 矢印:前年同期比での方向性	2024/3期		2025/3期		2026/3期	下期以降の方向性
	上期	下期	上期	下期		
パワー半導体用リードフレーム	5,996	5,115	5,396	5,103		
車載向け						EV市場の成長鈍化や世界的な新車需要減速の影響。現状が底だが、来期の回復はこの解消しだい。
民生・産機向け						調整局面が継続。来期以降の回復は緩やかと予想。
オプト用リードフレーム	1,374	1,272	1,470	2,029		
車載向け						来期は新規受注のハイエンド品の量産が本格化。
民生向け						新規受注のハイエンド品の生産増加。
コネクタ用部品	5,408	5,581	6,208	4,792		
車載向け						下期は国内メーカーの生産停止等で市場は底ばい。来期の回復はADAS拡大状況しだい。
モバイル向け						在庫調整完了。季節要因で下期は減少。来期は当期並の予想だが、新モデルの販売次第で増加の可能性あり。
ウェアラブル向け						在庫調整完了。市場成長に伴い来期は増加を予想。

- 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更、2025年3月期は71円(DOE2.5%)への増配を計画

2024年3月期以降の配当方針

- DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2025年3月期は71円配当を予定(DOE2.5%)

配当金・DOEの推移



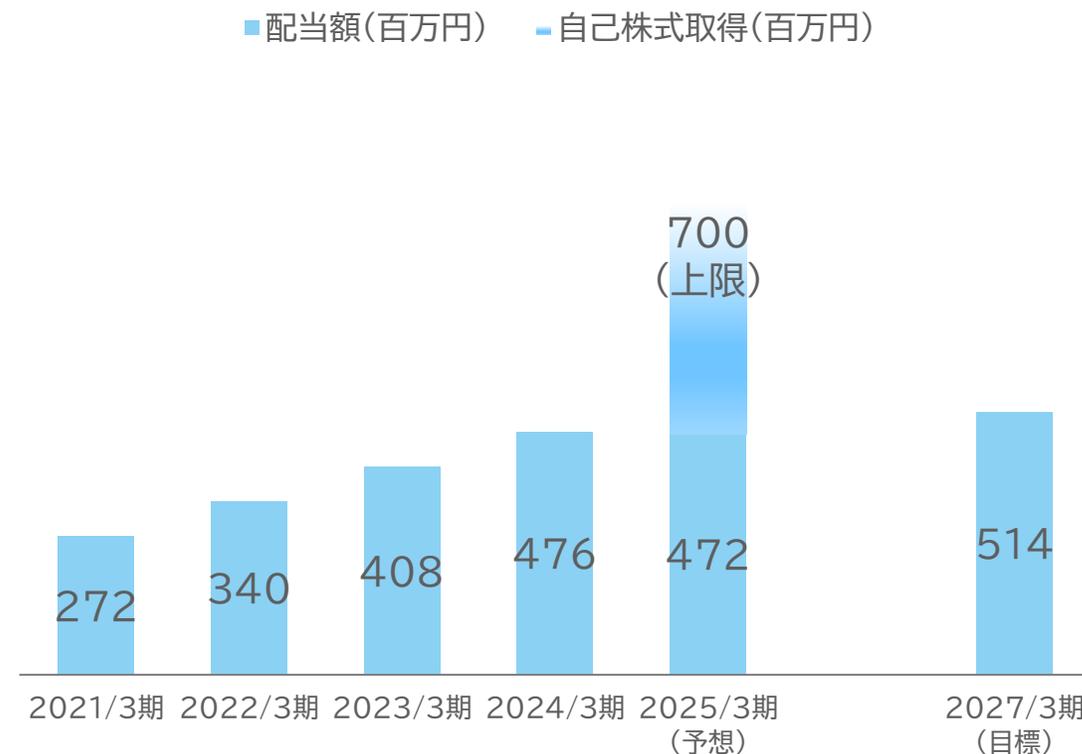
* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

- 機動的な資本政策の実行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を実施(8月9日公表)

自己株式取得

- 株式の種類：当社普通株式
- 取得株式総数：35万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合5.1%)
- 取得総額：7億円(上限)
- 取得期間：2024年8月26日～12月31日

株主還元の推移



* 25/3期の配当額は上限の自己株取得と株式報酬制度による交付が行われたものとして試算

(5)中期経営計画『ビジョン2030 2nd STEP』
(2025年3月期～2027年3月期)





ビジョン2030

「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で 暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

—— ありたい姿 ——

技術

- AI化と無人化による金型技術の進化で常に最先端の市場に向けて高品質な部品をスピーディーに提供し続ける

人材

- 失敗を恐れずチャレンジし多様な人財が活躍できる職場環境づくりを通じてイノベーションを生み新たな企業価値を創造する

環境

- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する
- 社会環境におけるリスクと機会を的確にとらえて行動することで信頼される企業であり続ける

- 自動車向けパワー半導体用リードフレームやハイエンドLED等の成長分野への投資により、2nd STEP最終年度は売上高300億円を計画
- 増収に加えて、メッキ工程の内製化やスマートファクトリーの推進による生産効率向上により営業利益は24億円、利益率も8.0%を計画

1st STEP実績(3カ年平均)

売上高
272億円

営業利益
12億円

ROE
4.7%

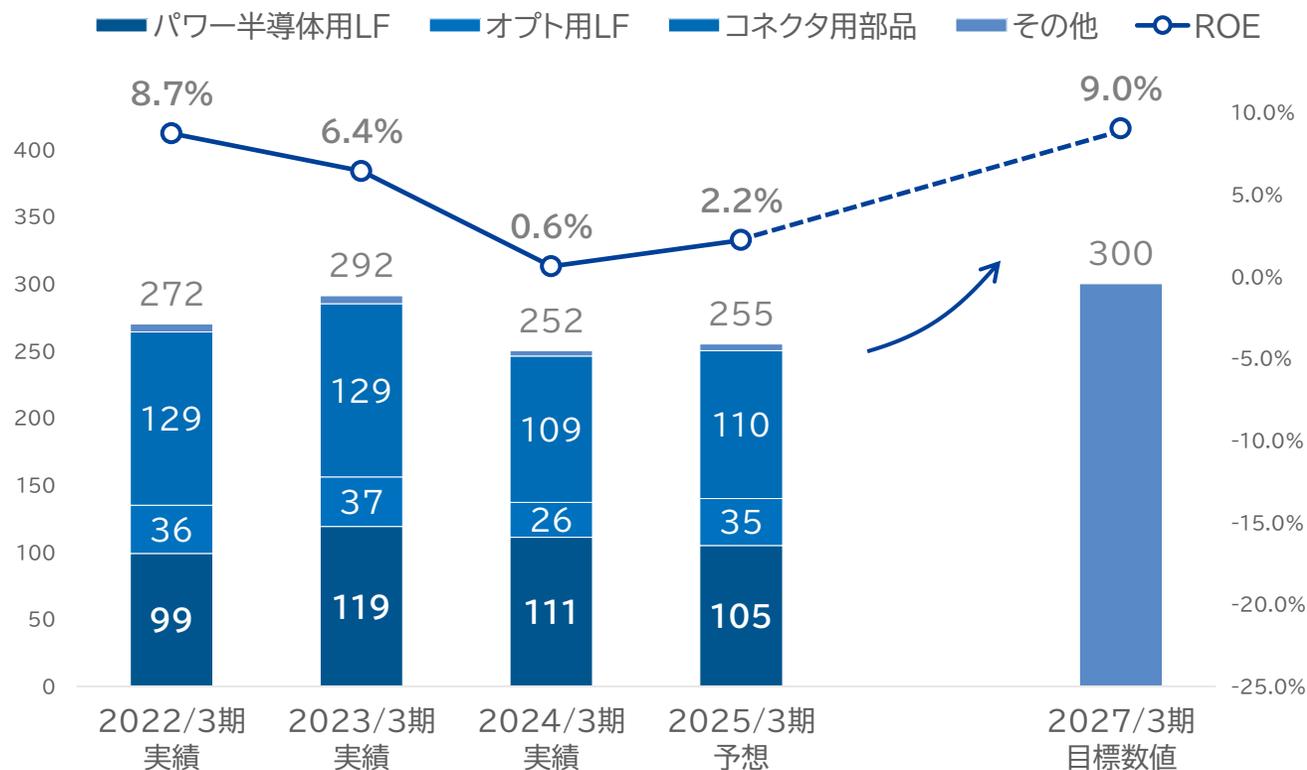
2nd STEP最終年度 目標数値

売上高
300億円

営業利益
24億円
(利益率8.0%)

ROE
9%

売上高・ROE



	主要施策	2027年3月期売上目標
パワー半導体用 リードフレーム	<ul style="list-style-type: none">材料メーカーや協力会社とのタイアップによる、顧客のニーズにマッチした提案の強化新規顧客に向けた次世代製品の拡販	2024/3期 111億円 → 2027/3期 120億円
オプト用 リードフレーム	<ul style="list-style-type: none">全社的な増産体制の構築(津軽工場の最大活用)さらなる受注拡大に向けた生産技術力の強化	2024/3期 26億円 → 2027/3期 50億円
コネクタ用部品	<ul style="list-style-type: none">狭ピッチ・低背化への挑戦技術者の育成一貫生産体制のさらなるレベルアップ 「最高レベルの品質」「価格競争力」「安定供給」	2024/3期 109億円 → 2027/3期 125億円

- 金型製作において、1st STEPでは経験値の可視化を実施、2nd STEPでは経験値・職人技を共有し、精密加工の無人化を進める
- 量産工程では、1st STEPで津軽工場・エノモト中山(中国)にメッキラインを増設、複数品目で徐々に量産開始
2nd STEPで量産化による付加価値向上を図る

主な製品の製造工程と収益力・現場力向上施策



- 1st STEPではIoT×新ERPシステムによる「ものづくりの見える化」に着手
- 2nd STEPでは、データの収集と検証を継続して行い、AIの活用に向けた体制整備を推進

1st STEP IoT×新ERPシステムによる
シームレスに連携したデータの生成
データのリアルタイム収集の実現

IoT活用



自動倉庫



AGV(無人搬送車)



2nd STEP ビッグデータの構築
「見える化」の推進

データの収集・検証

課題の即時把握

経営判断の迅速化



3rd STEP ビッグデータとAIの活用

高度なスマートファクトリー
最適化・自動化

AIによる学習・分析

高度な生産計画



- パワー半導体やハイエンドLED、マイクロコネクタ関連の生産対応を中心に50～60億円の設備投資を計画
- 研究開発は燃料電池部品の開発中心に3年間累計で3～5億円を計画



主要設備投資

- 新規製品受注による自社製作金型・周辺設備 15億円
- スマートファクトリー化に向けたデジタル投資 5億円
- 再エネ・省エネ投資 2億円

- 営業キャッシュフローによる成長投資の実施と安定的な配当を行い企業価値の最大化を図る
- 自己株式の取得により、株主還元額を期初計画の15億円から20億円に増額

3年間のキャッシュアロケーション



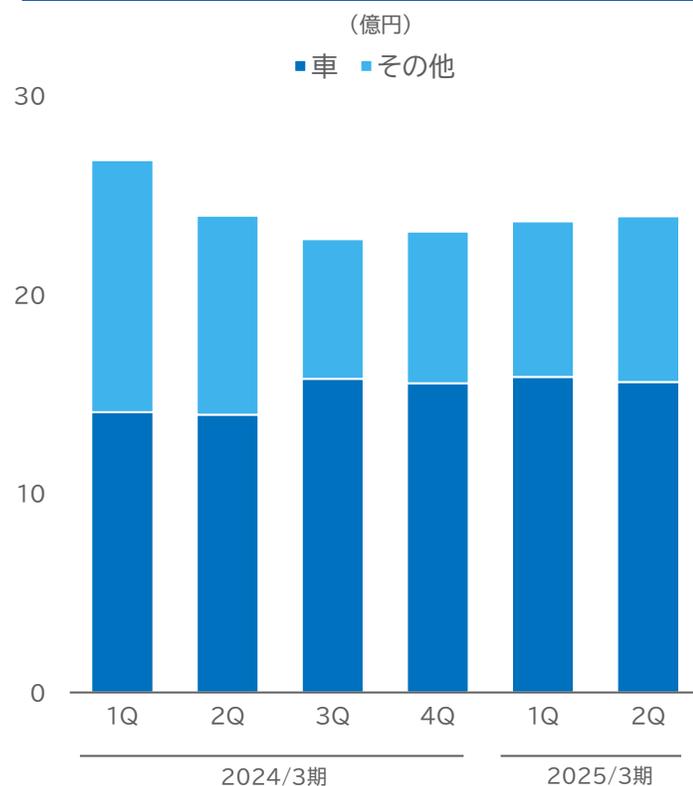
Appendix



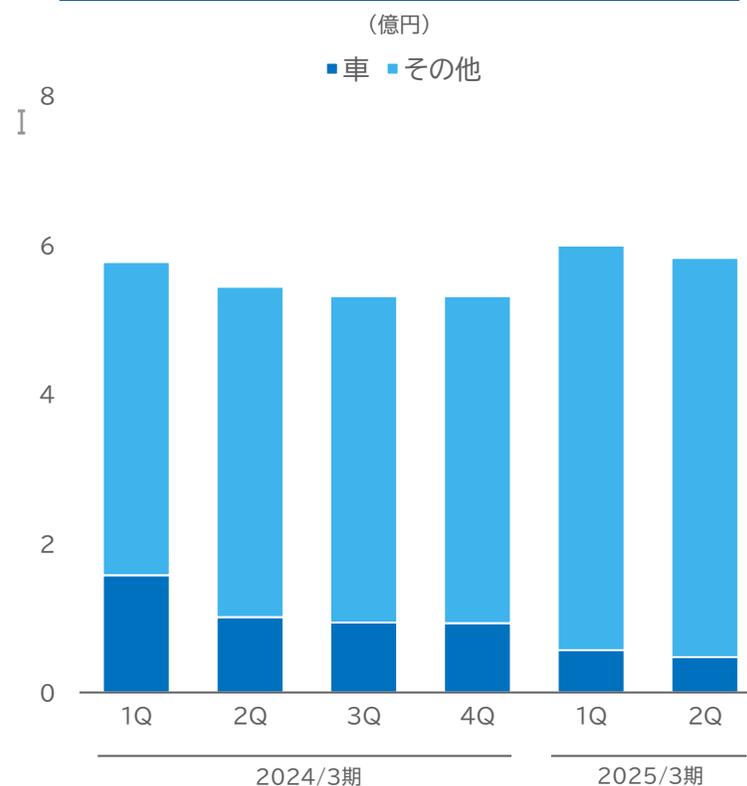
- 2024年3月期は海外工場のメッキ設備やコネクタ関係の金型投資を中心に18億円の設備投資を実施
- 2025年3月期はコネクタ用部品の自社金型の型数増加、上期は794百万円の設備投資、減価償却費は1,138百万円
- 減価償却費の増加は、自社金型償却費の増加による

単位:百万円	2023/3期	2024/3期	2025/3期予想	前期比増減
設備投資	2,979	1,809	1,855	46
パワー半導体用リードフレーム	897	500	448	△52
オプト用リードフレーム	307	278	141	△137
コネクタ用部品	1,136	848	1,159	+311
その他(調整等)	637	182	107	△75
減価償却費	1,717	1,885	2,022	+137

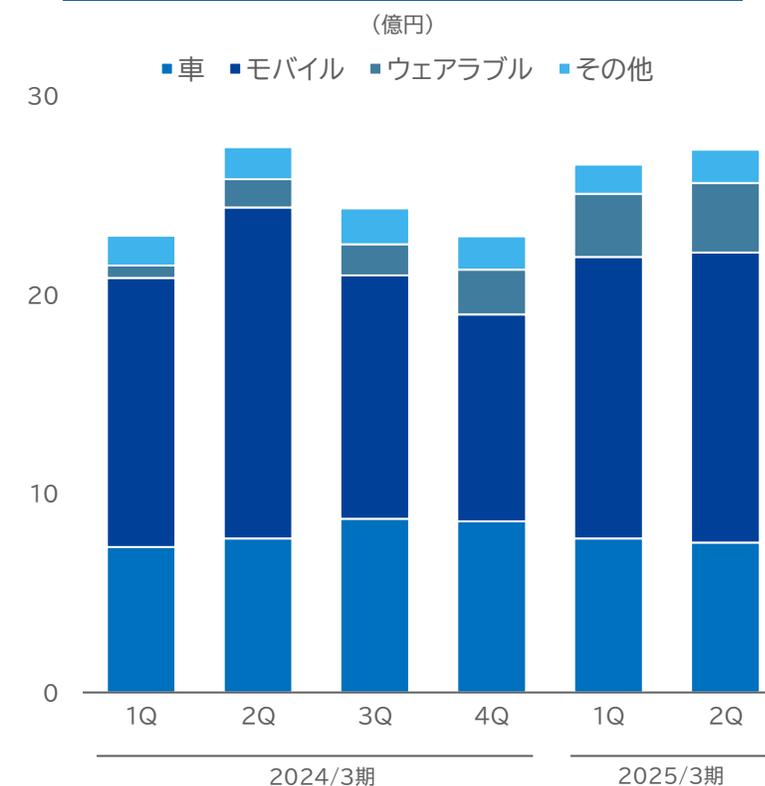
パワー半導体用リードフレーム



オプト用リードフレーム



コネクタ用部品



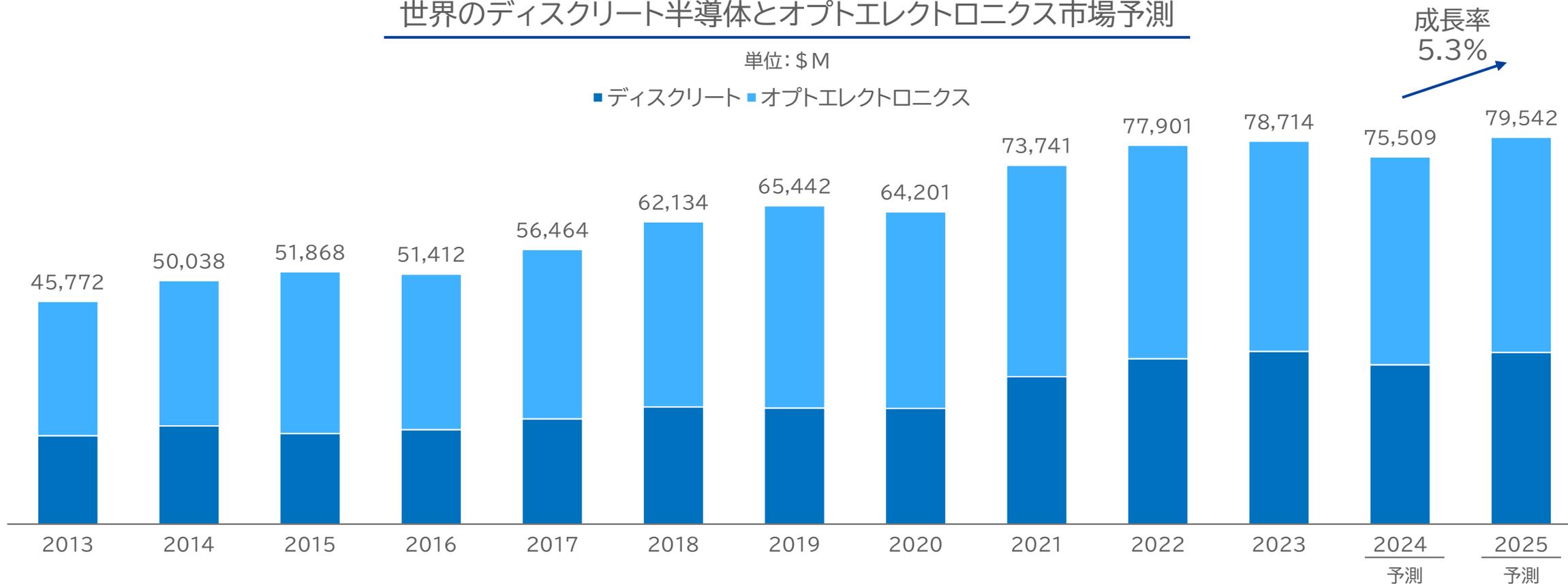
注:用途別量産品売上高は為替レートを固定した売上高で算出しており、製品群別売上高の数値とは一致しない

- ディスクリート市場は、パワー半導体等が車載やデータセンター、5G基地局向けなどにより中期的にも大きく成長
- オプトエレクトロニクス市場は、車載向けの搭載率上昇や、デジタルサイネージ・大型ディスプレイの需要回復などから堅調に推移

世界のディスクリート半導体とオプトエレクトロニクス市場予測

単位: \$M

■ ディスクリート ■ オプトエレクトロニクス

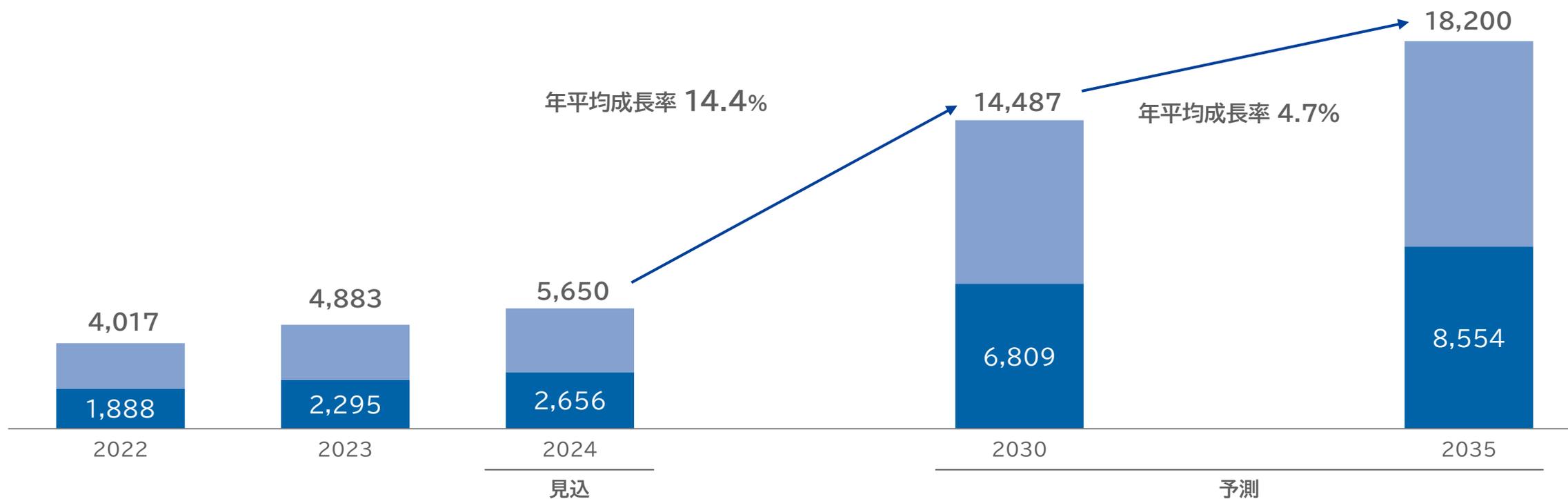


出所: WSTS「世界半導体市場統計」

- リードフレームを含むパワーデバイス構成部材*は2035年には1兆8,200億円へ2030年までの年平均成長率は14.4%を予測
- 構成部材のうち、約47%がリードフレームと推定

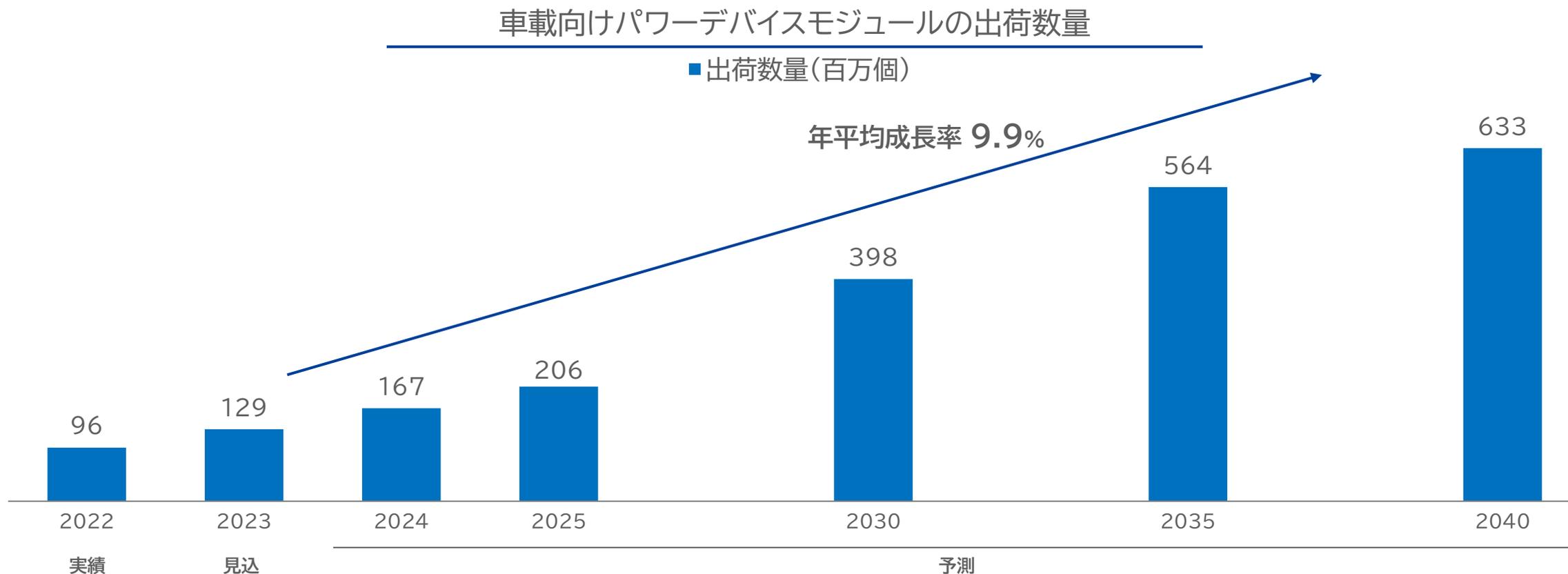
パワーデバイス構成部材の市場予測

■ リードフレーム ■ その他 (億円)



* 構成部材の市場はパワー半導体市場の内訳
出所:富士経済「2024年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望」

- 車載向けパワーデバイスモジュールの出荷数量は2040年までに年平均9.9%成長を予測
- 日本ではHV向け、欧州、北米、中国はPHV*やEV向けの製品が拡大

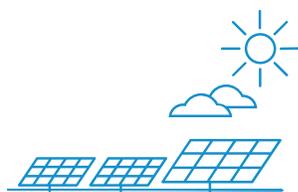


* PHVはPlug in Hybrid Vehicle の略
出所:富士キメラ総研「2023 次世代カーテクノロジーの本命予測」

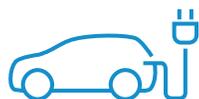
- 温室効果ガス排出実質ゼロの実現にはあらゆる分野・製品のエネルギー効率向上が必要
- 世界の電力の50~60%はモータで消費すると言われ、インバータによる効率的な電力の変換や制御のため高機能パワー半導体がキーデバイスとなる

「温室効果ガス排出実質ゼロ」の実現へ 「GX」とは ... 「パワービジネス」

あらゆる分野・製品のエネルギー効率向上



発電



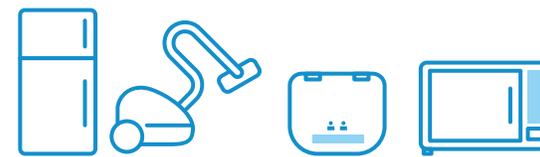
自動車(EV)



空調



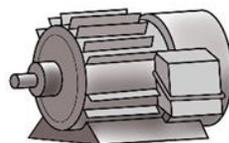
ロボット



家電/デジタル家電

省エネの実現

インバータ、コンバータ、レギュレータetc...



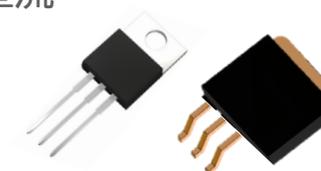
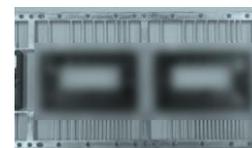
モータ

パワー半導体

整流

電圧変換

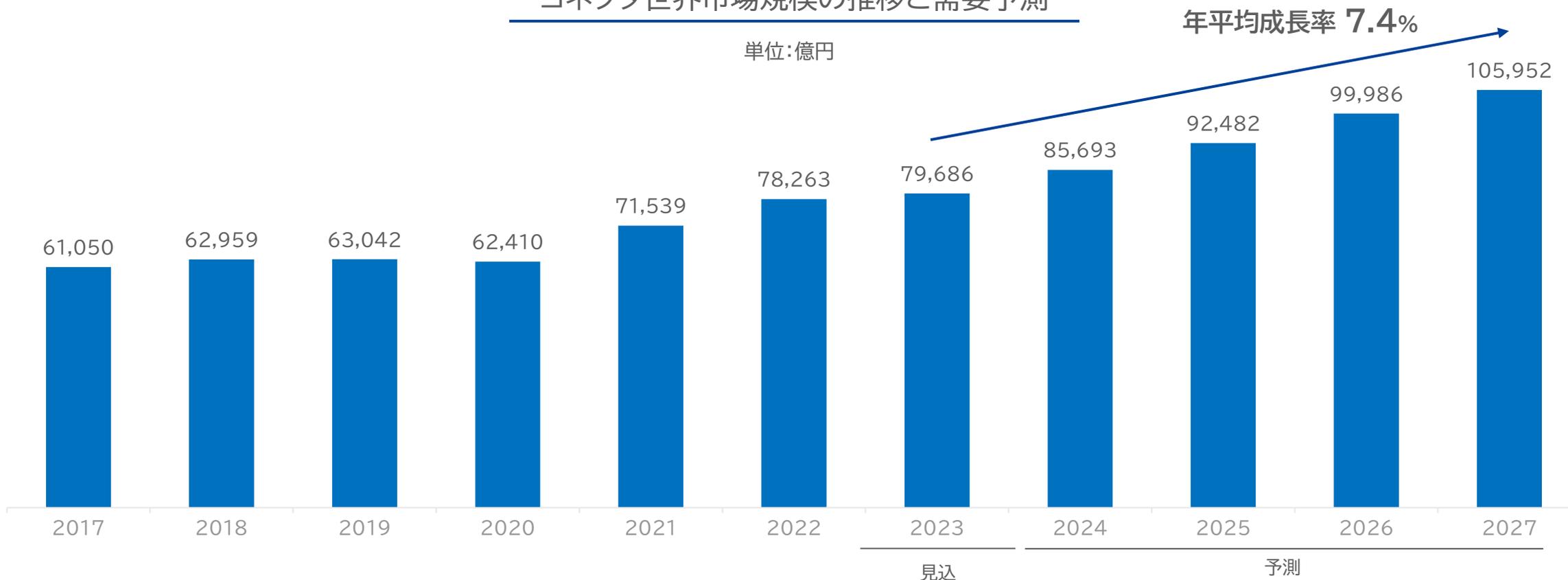
交流⇔直流



- コネクタ市場は年平均7.4%の成長が続くと予想
- 2023年以降はスマートフォン、ウェアラブル端末向けが一時的な調整を終え、堅調に増加することに加えて車載向けでEVシフトや自動運転技術の開発による部品の搭載率上昇
- 増大するデジタルデータ対応によるデータセンタ向けなどが市場を牽引

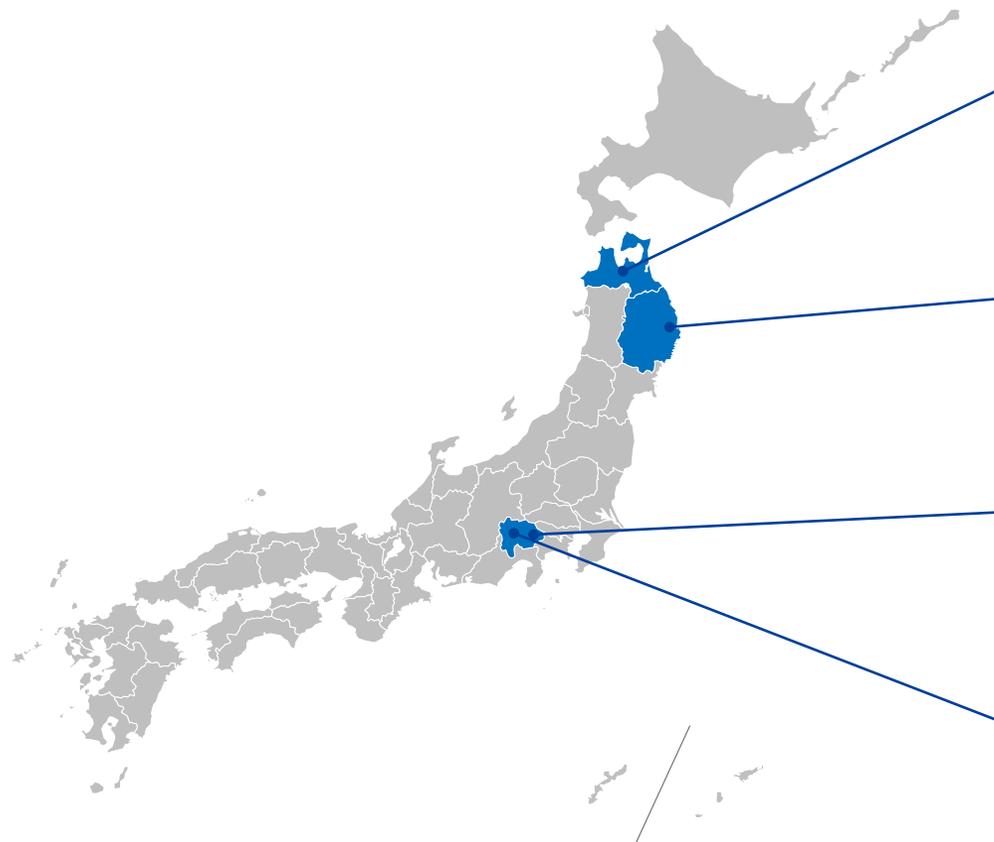
コネクタ世界市場規模の推移と需要予測

単位:億円



出所:産業情報調査会「2023年版 コネクタ市場」

- スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、マイクロコネクタの生産能力を増強
- リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・大電流対応品の生産体制を強化



津軽工場

主要生産品目
スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



岩手工場

主要生産品目
車載向け受動部品
スマートフォン向けコネクタ



本社工場(上野原)

主要生産品目
オプト用リードフレーム
リレー部品



本社工場(塩山)

主要生産品目
パワー半導体用リードフレーム
オプト用リードフレーム

- エノモト中山(中国)では、リードフレームやコネクタ用部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- エノモトフィリピンでは、車載向けのコネクタ用部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**
主要生産品目 パワー半導体用リードフレーム
スマートフォン向けコネクタ用部品

フィリピン



生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ用部品
車載向けスイッチ部品
パワー半導体用リードフレーム

注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。